

大阪技術研ベテラン研究員による、役立つ！ものづくり基盤技術・交流セミナー（第 4 回）

真空・薄膜技術による企業支援

～真空・薄膜技術の基礎から共同開発事例まで～

主催：MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪）、地方独立行政法人大阪産業技術研究所

協力：ドライコーティング研究会、（一社）日本真空学会関西支部

開催日 平成30年 **2/8（木）**
 時間 **18:30～20:00**（セミナー） **20:00～21:00**（交流会）
 場所 **クリエイション・コア東大阪** 北館3階 309号室
 東大阪市荒本北1-4-17（近鉄けいはんな線「荒本駅」下車5分）

講師： **電子・機械システム研究部 部長 岡本 昭夫**



真空技術の進歩とその応用産業の発展は近年めざましく、我々に身近な食品の真空包装やフリーズドライなどから、最先端のナノ技術を応用した半導体素子や究極の素粒子を研究する巨大な物理実験装置まで、広範な分野での重要なキーテクノロジーになっています。

今回のセミナーでは、真空技術とそれを用いた薄膜作製技術を分かりやすく解説するとともに、それらを用いた電子デバイスの共同開発事例を紹介します。

講演は、基礎的な内容から最近の話題までお話ししますので、企業の製造現場の方、研究開発、営業技術、経営者に至るまで、幅広い方を対象としています。講師は交流会にも参加しますので人的ネットワークづくりにもお役立て下さい。

参加費無料（交流会は 1,000 円）

定員 30 名（先着順）

ものづくり中小企業、支援機関

お申込み

「インターネット」または「FAX（下記の申込書に記載）」

※インターネットは、問合せ先のホームページにアクセスしてください。

お問合せ先

ものづくりビジネスセンター大阪（小川・磯） TEL：06（6748）1052

CHECK!

MOBIO
<http://www.m-osaka.com>

検索

から「MOBIO Cafe 開催案内」をご覧ください。

参加申込書

FAX 06-6748-1062 ※お一人ずつお申し込みください。切り取らずこのままFAXして下さい。

参加者氏名		企業名 部署・役職	
電話番号		FAX番号	
E-Mail			
住所	〒		
交流会	<input type="checkbox"/> 参加する <input type="checkbox"/> 参加しない		

※ 交流会は 20:00 より、南館 2 階テラスにて立食・軽食スタイルで開催します。（会費 1,000 円）

※ 本講習会参加申込みにかかる個人情報、主催者間で共有させていただきます。また、本申込書にご記入いただいた情報は、本講習会の参加者集計、その他催事情報提供などの案内を行う目的のみに使用します。